



58488

製品案内

低温熱活性フィルム 200μm厚 / 黒

製品の説明

tesa® LTR 58488は低温熱活性フィルムです。加熱と加圧により活性化する熱硬化性樹脂の中でも、比較的低温で活性化します。化学反応（架橋反応）が起きてポリマー同士が繋がるため、再加熱してもフィルムが軟化することはありません。硬化後は耐衝撃性に優れます。比較的低温で活性化するため、加熱に弱い素材との接着に適します。本製品はハロゲン化合物を含まないハロゲンフリー品です。また、RoHS(II)指令に適合しています。

特徴

- 総厚（ライナー含まず）：200μm
- 色：黒
- ライナー：シングル
- 熱硬化性樹脂の架橋反応により、強力に接合します。 * 常温ではタック（べたつき）がないフィルム状です。
- 様々な素材の被着体に対し、非常に高い接着性能を示します。
- ファブリック素材への濡れ性に優れます。
- PC（ポリカーボネート）などの樹脂の接合に好適です。

用途

- 各種デバイス部品とファブリック素材の貼り合わせ、アセンブリ

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|---------|------|--------|
| • 基材 | 無し | • 総厚 | 200 μm |
| • 粘着剤 | 低温活性粘着剤 | • 色 | 黒 |
| • ライナー | PEコート紙 | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|--------|----------------|-----------------------|
| • 低VOC | 非常に優れる | • 接着力（プッシュアウト） | 7.5 N/mm ² |
|--------|--------|----------------|-----------------------|

備考

貼り合わせ条件について

本製品の主成分は、加熱によって活性化する熱硬化性樹脂です。そのため、常温環境下では粘着性がないフィルム状です。活性化のためには、温度・圧力・時間をかける必要があります。お客様の求める接着強度へ到達させるためには、これに加え被着体の素材や接着面積などの条件を考慮する必要があります。以下に示す数値は製品選定時の目安として、お客様ご自身の評価に基づき貼り合わせ条件をご決定ください。

1) 仮圧着

被着体Aと本製品の貼り合わせ（位置合わせ）をおこないます。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=58488>

58488

製品案内

備考

設定条件 (例)

- 温度：50～60 °C (本製品の表面温度)
- 圧力：1～3 bar (治具から接着面にかかる圧力)
- 圧着時間：5～20秒間

2) 本圧着

本製品のライナーを取り除き、被着体Bと貼り合わせます。ヒートプレス機や加熱ローラー等で加熱と加圧を実施することで、熱硬化性樹脂の架橋反応を起こします。

設定条件 (例)

- 温度：75～110 °C (本製品の表面温度)
- 圧力：2～4 bar (治具から接着面にかかる圧力)
- 圧着時間：10～480秒間

留意点

- 温度と圧着時間の設定条件はそれぞれ関連しています。圧着時間を短く設定したい場合は圧着温度を高く設定してください (110°C未満)。同様に、圧着温度を低く設定したい場合は圧着時間を長く設定するか、短時間のヒートプレスとオープン硬化を併用してください。
- 最大限の接着性能を得るため、被着体の表面に汚れや水分が残っていないことを確認してください。
- 本圧着後、1～2時間程度で十分な接着強さを発揮します。架橋反応が進み、24時間程度で最大の接着強さに達します。そのため、本圧着直後に評価すると見かけ上強度が弱く見えることがあります。
- 出荷時のパッケージを未開封の状態、高温多湿を避けて保管してください。輸送・保管中は35°C未満の環境を保ってください。

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=58488>